



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻值: .03 Ω

电阻器类型: 电流传感电阻器

元件类型: 箔片

封装尺寸代码: 2010

额定功率: .75 W

所有 金属芯片电阻器：电流感应 (118)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
元件类型	箔片
封装尺寸代码	2010

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	.03 Ω
额定功率	.75 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	5 mm[.197 in]



产品宽度	2.5 mm[.098 in]
------	-----------------

使用环境

温度系数	±50 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | CGS TLM

表面贴装电阻器(143)

客户还购买了

TE 产品编号3-1393240-5
RT33L024

TE 产品编号2-1416010-7
RE034024

TE 产品编号966140-1
MESSERLEISTE 18P

TE 产品编号1-826656-3
13P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1-1393258-1
V23047-A1021-A501

TE 产品编号CAT-SCH691-T1
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流

TE 产品编号3-1879134-1
RN 0603 20K5 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号7-1625867-8
RP 1J 0.166W 40R2 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号5-1393236-7
V23092-A1905-A301

文档

TLM 2010 0.75W R030 1% 50PPM 4K RL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2176157-5_BA.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2176157-5_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2176157-5_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMD Current Sense Metal Chip Resistor](#)

英文版本